

半导体

证券研究报告

2021年08月07日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号: S1110517070005
panjian@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号: S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

联系人

chengruying@tfzq.com

行业走势图



资料来源: 贝格数据

相关报告

- 《半导体-行业研究周报:晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇》2021-08-02
- 《半导体-行业研究周报:AIoT 黄金时代已至,生态建立助力发展》2021-07-28
- 《半导体-行业研究周报:台积电上修半导体预期,持续看好国产设备材料》2021-07-19

海外半导体业绩指引高景气,持续看好代工厂估值修复机遇

本周行情概览: 本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 5.71%, 同期创业板指数上涨 1.47%, 上证综指上涨 1.79%, 深证综指上涨 2.45%, 中小板指上涨 2.85%, 万得全 A 上涨 2.34%。半导体行业指数跑输主要指数。

多家海外半导体龙头厂商新季报业绩超预期验证行业景气趋势。我们选取其中几家代表公司, 覆盖设备, 设计等子板块行业, 观察半导体产业的不同子板块的表现。

联发科 MTK 公布 2021 年第二季度财务报告。公司于 2021 年 7 月 27 日宣布 2021 年第二季度的营收总额为 1257 亿新台币, 同比增长 85.9%, 环比增长 16.3%, 营收再创新高; 毛利率 46.2%, 同比增长 2.7 个百分点, 环比增长 1.3 个百分点; 净利润为 276 亿新台币, 同比增长 277.4%, 环比增长 7%。本季营收较前季增加的主要原因为 5G 智能手机以及各类物联网装置动能持续。本季营收较去年同期增加的主要原因为 5G 智能手机和 WIFI 6 市占率的增加以及各类消费性电子销售提升。

赛灵思 Xilinx 发布 2021 年第一财季财报。公司于 2021 年 7 月 28 日宣布 2021 年第一财季收入达到创纪录的 8.79 亿美元, 比上一季度增长 3%。第一财季的 GAAP 净利润为 2.06 亿美元, 或每股摊薄收益 0.83 美元, 环比增长 11%。本季度非 GAAP 净利润为 2.36 亿美元, 或每股摊薄收益 0.95 美元。业绩提升主要受益于数据中心终端市场的强劲表现, 以及工业、广播和消费终端市场创纪录的季度收入。

阿斯麦 ASML 公布 2021 年第二季度财务报告,公司于 2021 年 7 月 21 日宣布 2021 年第二季度的营收额为 40 亿欧元, 同比增长 20.87%, 环比降低 7.88%; 毛利率 50.9%, 同比增加 2.7 个百分点, 环比降低 3 个百分点; 净利润 10 亿欧元, 同比增加 38.22%, 环比降低 22.01%。业绩提升主要受益于客户希望采用软件升级来快速提高产能。第二季度的新增订单金额达到 83 亿欧元, 其中 49 亿欧元来自 EUV 系统订单, 总待出货订单金额(backlog)达到 175 亿欧元。

高通 Qualcomm 于 2021 年 7 月 28 日公布 2021 年第三季度财务报告, 业绩高于预期上限, 非 GAAP 收入为 80 亿美元, 同比增长 63%, 非 GAAP 每股收益为 1.92 美元。物联网业务将是公司未来增长的机会之一, 目前的增长速度是手机业务增长速度的 1.6 倍, 物联网和汽车业务, 令产品组合更加优化, 增加了公司的营业收入。

超威半导体 AMD 于 2021 年 7 月 27 日公布 2021 年第二季度财务报告, 营业额 38.5 亿美元, 同比增长 99%; 毛利率扩大至 48%, 环比增长 12%; 毛利率 48%, 同比增长 4 个百分点, 环比增长 2 个百分点; 净利润 7.1 亿美元, 同比增长 352%, 环比增长 28%。业绩增长得益于计算和图形部门以及企业和嵌入式和半定制部门的收入增加。

三星电子公布于 2021 年 7 月 29 日公布 2021 年第二季度财务报告, 营收 63.67 万亿韩元, 同比增长 20%; 毛利率 41.8%, 环比增长 5.3 个百分点; 净利润 9.63 万亿韩元, 同比增长 73.2%, 环比增长 34.8%。半导体部门营收 22.74 万亿韩元, 同比增长 25%, 营业利润为 6.93 万亿韩元, 同比增长 28%, 环比翻番。高增长原因为 1) 疫情下非接触式生活方式走向常态, 带动电脑芯片销售增长, 2) 云计算企业对数据中心服务器的需求上升推高 D-RAM 价格+NAND 闪存价格上升, 3) 奥斯汀工厂复工。展望第三季度, 合作公司拟在第三季度推出中央处理器和智能手机, 这将推高 D-RAM 等存储芯片的需求, 因此半导体部门第三季的营业利润有望达到顶点。

高景气度下, 持续看好国产设备材料, 同时看好晶圆代工板块估值修复的机遇。从 PB 估值来看, 中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。中芯国际 (A 股及港股) 和华虹半导体自今年二季度以来显著跑输芯片 ETF。截至 2021/7/30, 中芯国际港股 PB 仅 1.80, 是全球 PB 最低的晶圆代工资产, 华虹半导体为 3.22xPB, 也处于较低水位, 中芯国际 A 股 5.07xPB。

基本面持续强化, 涨价+UTR 提升+产品结构优化, 一季度制造板块毛利率环比提升, 二季度有望持续提升。中芯国际二季度营收超 13 亿美元再创新高, 毛利率提升为 30.1%, 华虹半导体 8 月 12 日发布业绩。大陆晶圆代工供需缺口大, 中芯华虹扩产趋势明确, 晶圆代工成为中美博弈焦点, 未来 5 年有望持续扩产。战略性看多本土晶圆代工资产, 看好估值修复行情。

建议关注: IDM: 闻泰科技/三安光电; 晶圆代工: 中芯国际/华虹半导体; 半导体设备材料: 北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微; 半导体设计: 紫光国微/上海复旦/晶丰明源/兆易创新/晶晨股份/全志科技/瑞芯微/中颖电子/富瀚微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导/新洁能/澜起科技

风险提示: 疫情继续恶化; 贸易战影响; 需求不及预期

内容目录

1. 本周半导体行情回顾.....	3
2. 本周重点公司公告.....	4
3. 本周半导体重点新闻.....	7
3.1. IC 设计.....	7
3.2. 设备/材料.....	8
3.3. 代工/封测.....	8
3.4. EDA/IP/其他.....	9
4. 海外半导体龙头厂商新季度业绩持续向好.....	10
5. 周观点.....	18
6. 风险提示.....	19

1. 本周半导体行情回顾

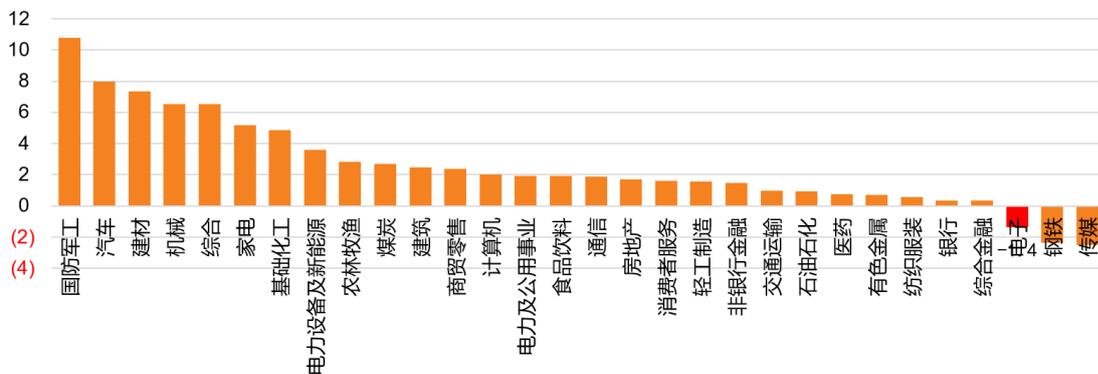
本周半导体行情显著跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 5.71%，同期创业板指数上涨 1.47%，上证综指上涨 1.79%，深证综指上涨 2.45%，中小板指上涨 2.85%，万得全 A 上涨 2.34%。半导体行业指数显著跑输主要指数。

表 1: 本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	1.47	-7.19
上证综合指数	1.79	-7.50
深证综合指数	2.45	-8.16
中小板指数	2.85	-8.56
万得全 A	2.34	-8.05
半导体 (申万)	-5.71	-

资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 1: 本周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

半导体子板块中其他板块涨幅居前，其余各子板块略有回调。细分板块中，其他板块本周上涨 14.6%，封测板块本周下跌 0.8%，分立器件板块本周下跌 0.9%，半导体制造板块本周下跌 1.7%，IC 设计板块本周下跌 3.8%，半导体材料板块本周下跌 4.8%，半导体设备板块本周下跌 10.7%。**天风电子团队持续看好半导体设备材料板块的机会**，5 月 24 日报告《后摩尔时代，国产半导体设备材料有预期上修空间》中明确提出“当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。”6 月 16 日报告《持续看好国产半导体设备材料》重申观点，目前我们持续看好设备材料板块。

图 2: 本周子板块涨跌幅 (%)

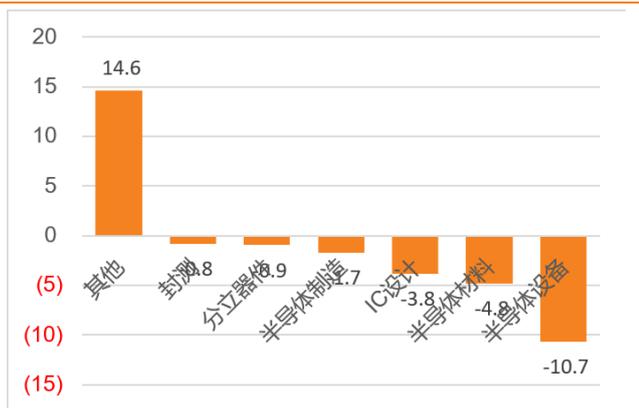
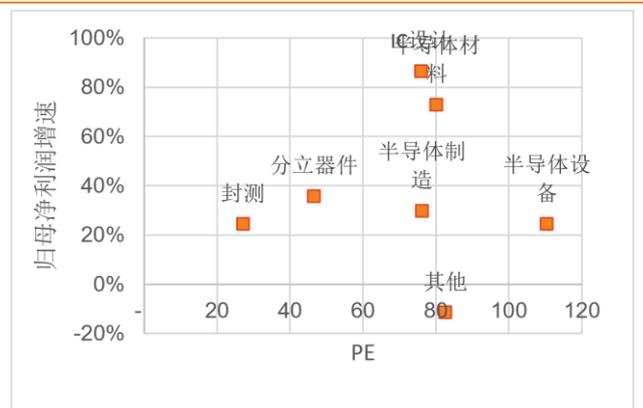


图 3: 半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

资料来源：Wind，天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为：东软载波、神工股份、永太科技、芯原股份-U、隆华科技、景嘉微、振华科技、振芯科技、北斗星通、芯朋微。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为：江化微、博通集成、芯源微、斯达半导、容大感光、明微电子、国民技术、华峰测控、全志科技、中微公司。

表 2：本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅
东软载波	62%	江化微	-15.3%
神工股份	41%	博通集成	-16.1%
永太科技	39%	芯源微	-17.0%
芯原股份-U	27%	斯达半导	-17.6%
隆华科技	24%	容大感光	-17.8%
景嘉微	15%	明微电子	-17.9%
振华科技	14%	国民技术	-18.0%
振芯科技	14%	华峰测控	-19.0%
北斗星通	12%	全志科技	-20.1%
芯朋微	11%	中微公司	-20.3%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2. 本周重点公司公告

【神工股份 688233.SH】

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 204,04.97 万元，同比增长 354.80%；完成归属于上市公司股东的净利润 100,03.41 万元，同比增长 415.40%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,97.29 万元，同比增长 770.50%。报告期末，公司资产总额 1,388,98 万元，同比增长 3.00%。

公告显示，半导体行业发展处于上行周期，凭借一流的技术和稳定的品质，公司主营产品订单大幅增加，使得营业收入大幅提升，净利润、扣除非经常性损益的净利润都大幅增长。

【润欣科技 300493.SZ】

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 85159.54 万元，同比增长 48.94%；完成归属于上市公司股东的净利润 2813.64 万元，同比增长 60.15%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2733.28 万元，同比增长 72.33%。报告期末，公司资产总额 114995 万元，同比增长 5.56%；归属于上市公司股东的净资产 76345.71 万元，同比增长 1.82%。

公告显示，主要系上年同期因疫情影响，销售收入减少，本报告期销售规模扩大。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。公司的核心竞争力主要体现在对 IC 产品的设计和市场定位能力。具体来说，公司的竞争优势主要体现为拥有的 IC 设计供应商和重要客户资源、产业整合和专业技术能力等方面。

【富满电子 300671.SZ】

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入

入 85087.41 万元，同比增长 239.31%；完成归属于上市公司股东的净利润 31616.69 万元，同比增长 1190.55%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30392.41 万元，同比增长 1601.87%。报告期末，公司资产总额 213470.52 万元，同比增长 29.20%；归属于上市公司股东的净资产 132634.62 万元，同比增长 27.98%。

公告显示，旺盛的下游需求和持续的产品迭代推动公司进入发展快车道，在各条产品线高景气的驱动下，公司营业收入实现快速增长；持续高强度的研发为公司未来发展提供了丰富的产品储备，2021 年上半年，公司研发投入 6754.83 万元，同比增长 213.04%；工艺持续迭代以及与晶圆厂良好的合作关系为公司未来发展提供了产能保障。

【芯原股份 688521.SH】

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 87310.43 万元，同比增长 26.92%；完成归属于上市公司股东的净利润-4564.5 万元，亏损收窄 1,823.33 万元，收窄幅度为 28.54%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7794.01 万元，扣非后亏损收窄 401.44 万元。报告期末，公司资产总额 345554.66 万元，同比增长 8.15%；归属于上市公司股东的净资产 261657.66 万元，同比减少 0.38%。

公告显示，2021 年上半年，在全球疫情逐步得到控制、国际局势持续起伏、半导体产业链产能紧张的背景下，公司经营情况良好，各业务协同发展，实现营业收入的显著增长及归属于母公司所有者的净亏损进一步收窄。公司营业收入的增长主要由公司一站式芯片定制服务业务所驱动；公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、库存风险、技术支持费用等方面有所不同，公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势。因此，基于公司独特的商业模式，综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产业务毛利率相对半导体 IP 授权业务较低，但该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

【思瑞浦 688536.SH】

公司于 2021 年 8 月 5 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 48475.15 万元，同比增长 60.56%；完成归属于上市公司股东的净利润 15,476.39 万元，同比增长 26.78%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11818.72 万元，同比下降 1.93%。报告期末，公司资产总额 293952.8 万元，同比增长 10.33%；归属于上市公司股东的净资产 276975.4 万元，同比增长 7.62%。

公司公告显示，本期经营活动现金净流出为 2,027.75 万元，较上年同期下降 115.87%，主要系以下原因所致：（1）应对集成电路行业上游产能趋紧的状况，通过预付供应商货款的方式，保障供应链的持续稳定；（2）公司人员增加及薪酬水平增长导致支付给职工及为职工支付的现金增长；（3）公司内销销售额同比大幅增加，导致缴纳的增值税大幅增加。报告期内，公司电源产品成长快速，收入结构趋向均衡；各关键岗位人才资源进一步充实，团队规模持续壮大；凭借可靠的产品质量和优质的客户服务，市场拓展不断取得新成果；通过与产业链合作伙伴积极协作，共同应对产能紧张带来的诸多挑战，维护供应链稳定。

【晶丰明源 688368.SH】

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。公告显示，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买参股公司南京凌鸥创芯电子有限公司 95.75% 股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

【纳思达 002180.SZ】

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公告显示，上市公司拟向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付现金收购其持有的奔图电子 100% 股权。本次交易完成后，奔图电子将成为上市公司全资子公司。本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 500,000 万元，且不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。

【太极实业 600667.SH】

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告》。公告显示，无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）于近日收到招标代理机构安徽省招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技为长鑫新桥存储技术有限公司 12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 EPC 总承包的中标单位。

【汇顶科技 603160.SH】

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。公告显示，2021 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 90,000 股，占公司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 115.5 元/股，最低价为 111.96 元/股，已支付的总金额为 10,312,482.39 元（含交易费用）。

自本次回购实施开始至 2021 年 7 月 31 日，公司股份回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为 3,422,700 股，占公司总股本的比例为 0.75%，购买的最高价为 124.69 元/股，最低价为 111.96 元/股，已支付的总金额为 411,325,948.73 元（含交易费用）。

【芯原股份 688521.SH】

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。公告显示，2021 年 8 月 3 日为授予日，以人民币 38.53 元/股的授予价格向 62 名激励对象授予 41.20 万股限制性股票。预留授予数量：41.20 万股，约占目前公司股本总额 49,019.6451 万股的 0.08%，授予价格 38.53 元/股。

【南大光电 300346.SZ】

公司于 2021 年 8 月 5 日公告《向特定对象发行股票发行情况报告书》。公告显示，本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 61,300.00 万元（含本数），股票数量不超过 19,114,437 股，且不超过发行前总股本的 30%，即不超过 122,067,253 股（含本数）。

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）15,290,596 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即 2021 年 7 月 22 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 32.07 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 40.09 元/股，发行价格为发行底价的 1.25 倍。

【晶方科技 603005.SH】

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《简式权益变动报告书 (EIPAT)》。公告显示，权益变动前，EIPAT 持有晶方科技 30,752,000 股股份，占晶方科技当时总股本的 9.56%。本次权益变动后，EIPAT 持有晶方科技 20,367,281 股股份，占晶方科技目前总股本的 4.99%，为晶方科技 5%以下股东。

3. 本周半导体重点新闻

3.1. IC 设计

思瑞浦 2021 年 H1 营业收入同比增长 60.56%。思瑞浦于 8 月 4 日晚间披露半年报，2021 年上半年营业收入 4.85 亿元，同比增长 60.56%；净利润 1.55 亿元，同比增长 26.78%；基本每股收益 1.93 元。思瑞浦主要从事模拟集成电路产品的研发与销售，报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。本期营业收入为 48,475.15 万元，其中，信号链模拟芯片收入同比增长 40.86%，占本期销售收入的比例为 85.51%；电源管理模拟芯片收入同比增长 816.68%，占本期销售收入的比例为 14.49%。

小米投资芯片设计公司。湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）新增投资企业——武汉市聚芯微电子有限责任公司（以下简称：聚芯微）。值得一提的是，早在 2019 年 4 月，聚芯微就获得了“OPPO 系”盛铭企业管理咨询有限公司的投资。聚芯微成立于 2016 年，专注于高性能模拟与混合信号芯片设计领域，总部位于武汉光谷未来科技城。据悉，聚芯微定位智能感知领域，目前拥有智能音频、3D 视觉、光学传感和触觉感知等多条产品线布局，并获得多家一线手机品牌联合战略投资。（集微网）

复旦微电登录科创板。8 月 4 日，复旦微电正式登陆科创板，股票代码为 688385，发行价格 6.23 元/股，发行市盈率为 127.14 倍。招股书显示，复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。2018 年-2020 年，复旦微电实现净利润分别为 1.05 亿元、-1.63 亿元和 1.33 亿元，扣非后净利润分别为 1566.65 万元、-2.55 亿元和 3987.90 万元。目前，复旦微电的 RFID 芯片、智能卡芯片、EEPROM、智能电表 MCU 等多类产品的市场占有率位居行业前列，且产品性能受到三星、LG、VIVO、海尔、海信、联想等国内外知名厂商的认可。（集微网）

地平线发布整车智能芯片征程 5。地平线于近日发布了动力最为强劲的“数字发动机”——全场景整车智能中央计算芯片地平线征程 5。这是继突破 L4 高等级自动驾驶算力瓶颈之后，国内车规级芯片厂商开始攀登整车智能芯片的新高度。而自 2020 年地平线按下中国智能汽车芯片的前装量产元年按钮后，地平线芯片出货量已突破 40 万片，获得 40 多个前装量产项目定点。地平线也是目前国内唯一一家实现汽车智能芯片前装量产的企业，其首款车规级 AI 芯片地平线征程 2，实现了中国车规级 AI 芯片量产零的突破。（集微网）

振芯科技测试产线已超负荷运转，重点产品测试依靠委外。近日，振芯科技在接受机构调研时表示，公司现有的研发、测试产线已处于饱和、超负荷运转，重点产品测试依靠委外，

由于外部交付周期和成本不可控，从长远来看，一定程度上影响了公司订单的交付和业务的正常开展。对于控股股东诉讼进展，振芯科技表示，电子集团及其股东在电子集团公司解散之诉审理期间衍生出多起诉讼，目前仍有诉讼处于未决状态。电子集团公司解散一案已处于恢复审理过程中，电子集团的僵局问题继续存在。该诉讼不影响公司的日常生产经营。（集微网）

谷歌手机将采用自研芯片。近日，谷歌宣布其最新旗舰手机 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 将不再采用高通处理器，转而采用自研 Tensor 系统单芯片。有评论认为，随着谷歌加入自研芯片潮，晶圆代工的“大饼”将越来越大，台积电、三星甚至是英特尔受依赖程度会越来越高。苹果去年便宣布，以自研的 M1 芯片，取代目前 Mac 电脑使用的英特尔芯片；谷歌此前就曾与博通合作，为自身大型数据中心服务器开发 Tensor Processing Unit，以加速定制化 AI 演算法的运算，来协助在云端中识别和分析影像、语言、文字片段和影音。（集微网）

3.2. 设备/材料

盛美步入边缘刻蚀领域，新产品支持 3D NAND、DRAM 和先进逻辑制造工艺。作为半导体制造与先进晶圆级封装领域中领先的设备供应商，盛美半导体设备今日公布的边缘湿法刻蚀设备，进一步拓宽了盛美湿法设备的覆盖面。该新设备使用湿法刻蚀方法来去除晶圆边缘的各种电介质、金属和有机材料薄膜，以及颗粒污染物。这种方法最大限度地减少了边缘污染对后续工艺步骤的影响，提高了芯片制造的良率，同时整合背面晶圆清洗的功能，进一步优化了工艺和产品结构。（集微网）

半导体设备荒正在加剧。据韩国半导体企业相关人士和 TheElec 收集的全球半导体企业数据显示，截至 7 月，半导体设备的平均交货周期已延长至 14 个月，一些晶圆厂设备的交货时间超过了两年。TheElec 指出，去年，晶圆厂设备的交货期在 3 到 6 个月之间，今年第一季度延长到了平均 10 个月。交期的延长是由于芯片制造商增加了对晶圆厂的支出，以及全球芯片短缺的长期化，甚至连设备制造商都要采购他们产品所需的芯片。部分知情人士表示，用于前端工序的设备，通常有较短的交货期，但目前其交期平均也超过了一年。设备的交货时间总体上处于历史最高水平。（集微网）

半导体晶圆检测设备企业大摩半导体项目落户上海松江。上海松江消息显示，今年年初，松江区区投促中心了解到大摩半导体在半导体晶圆检测设备突破“卡脖子”技术、实现国产化方面取得了突破性进展，企业正在选址设立总部、研发及生产基地。最终，项目方确定落户松江。据悉，江苏大摩半导体科技有限公司成立于 2017 年，主要为客户提供集成电路及半导体晶圆检测设备的整合解决方案。近年来，公司已成长为国内半导体晶圆检测设备再制造与技术服务领域的龙头企业，并积极加快检测设备核心模块的开发，将联合行业内的相关企业进行检测设备整机开发。（集微网）

3.3. 代工/封测

中芯国际发布 2021 年第二季度财报，单季营收创下 13.44 亿美元新高，环比增长 21.8%，同比增长 43.2%。今年第二季度，中芯国际毛利达到 4.05 亿美元，环比增长 61.9%，同比增长 62.9%。此外，毛利率也从第一季度的 22.7% 大幅提升到了 30.1%。值得一提的是，中芯国际第二季度财报还透露出两大关键信息，一是在全球芯片产能吃紧之际，中芯国际第二季度来自中国内地及中国香港的营收占比从上季度的 55.6% 提升到了 62.9%；二是中芯国际 28nm 及 FinFET 制程营收贡献占比实现反弹，上季度受外部因素影响下跌至 6.9% 后，今年第二季度迅速反弹至 14.5%。（集微网）

长江存储 128 层 3D NAND 闪存产品成功量产。国内内存模块供应商“嘉合劲威”公众号发布消息称，旗下高端品牌阿斯加特将发布新品 AN4 PCIe4.0 SSD，闪存颗粒采用长江存储 128 层 3D TLC NAND，这也意味着长江存储 128 层 3D NAND 闪存产品成功量产。2018 年长江存储的技术水平是 32 层，而三星电子从 2014 年开始生产 32 层。随着长江存储在 2021 年成功量产 128 层（三星电子和 SK 海力士分别在 2019 年 8 月和去年第二季度开始生产 128 层），韩国和中国半导体企业的技术差距从 3、4 年缩短为 2 年。（集微网）

台积电 3nm 制程今日起启动机台设备安装。继 5nm 制程开始显著贡献营收后，3nm 也预计在今年下半年试产，并于明年下半年量产。据中国台湾《自由时报》报道，台积电南科晶圆 18 厂是其 5nm 和 3nm 的主要生产基地。台积电总裁魏哲家日前表示，5nm 在进入量产的第二年，具有最佳的性能、功耗及面积（PPA），在智能手机、高性能计算（HPC）相关应用的驱动下，需求持续强劲。（集微网）

富士康购买 6 寸晶圆厂。近日，富士康以 9000 多万美元从存储器企业宏旺手中购买一家 6 寸晶圆厂，富士康将以此开发碳化硅芯片，它将保留这些设施和设备以便开发碳化硅芯片，进而开始布局汽车芯片市场。富士康将于今年年底完成该 6 寸晶圆制造厂的收购，并计划刚于 2024 年月产能达到 15,000 片晶圆。富士康此前曾表示将参与全球电动汽车市场，此次收购宏旺的晶圆厂，可谓真正的迈开了第一步。今后，富士康将分别与菲斯克、拜腾等合作生产电动汽车。（集微网）

大港股份控股孙公司有光刻机。8 月 3 日，大港股份在投资者互动平台表示，目前公司控股孙公司苏州科阳主要从事 8 寸 CIS 晶圆级封装加工服务，CIS 芯片主要应用于手机摄像头。对于光刻机方面，大港股份称公司控股孙公司苏州科阳有上述设备，此外，公司还透露，苏州科阳主要从事 8 寸 CIS 晶圆级封装加工服务，CIS 芯片主要应用于手机摄像头。据悉，大港股份和紫光展锐主要在集成电路测试业务上有合作。（集微网）

晶圆代工先进制程要涨价了。外媒报导，南韩三星电子透露有意调涨晶圆代工价格，由于三星晶圆代工主力在先进制程，其喊出要调升价格，业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪，也意味晶圆代工市场盛况从成熟制程一路延烧到先进制程。在三星之前，联电、力积电等以成熟制程的晶圆代工厂，都已陆续上调代工报价，联电更二度上修今年全年产品均价（ASP）增幅，凸显报价涨势比原本预期还大。台积电方面，先前成熟制程部分调升报价或取消价格折让惯例，但在先进制程报价方面，则无明显波动。（集微网）

3.4. EDA/IP/其他

芯原股份上半年营收同比上升 27%，增长主要是公司一站式芯片定制服务业务所驱动。8 月 4 日，芯原股份披露半年度报告称，2021 年上半年，公司实现营业收入分别为 8.73 亿元，同比增长 26.92%。其中，第二季度实现营业收入 5.41 亿元，同比增长 40.95%，其增长主要是公司一站式芯片定制服务业务所驱动。另外，上半年，芯原股份新签订单金额约 17.22 亿元，较上年同期增幅超 120%，主要来自芯片量产业务。（集微网）

智芯仿真获华大九天战略投资，致力于解决 EDA 后端仿真软件“卡脖子”问题。近日，智芯仿真获得华大九天的战略投资。此轮融资后，智芯仿真将扩大团队规模，加快产品研发进度。智芯仿真成立于 2019 年，专注于 EDA 后端版图验证与仿真领域，产品覆盖电路版图的直流分析与电-热协同仿真、信号完整性分析、电源完整性优化及电路模型的参数

提取等。公司的目标是为电子和集成电路设计企业提供平台化的 EDA 后端仿真软件系统，实现国外软件的国产替代，解决 EDA 后端仿真软件的卡脖子问题。（集微网）

新思葛群称 EDA 软件应发挥“美图秀秀魔力”，助力芯片设计门槛大幅降低。新思全球资深副总裁兼中国董事长葛群日前接受《问芯 Voice》等媒体的采访中表示，未来 EDA 的角色很重要的一个改变就是能够让整个芯片设计的门槛降低，让更多人能够参与到芯片设计当中来，EDA 也可以像美图秀秀等工具一般，让芯片设计从业者可以迅速地规模化地做出芯片产品，从而降低成本，也可以更容易让人才加入到芯片产业当中（集微网）

4. 海外半导体龙头厂商新季度业绩持续向好

多家中国台湾及海外半导体企业发布最新季度财务报告，业绩持续向好。我们选取其中几家代表公司，覆盖设备，设计等子板块行业，观察半导体产业的不同子板块的表现。

1. 联发科（MediaTek.Inc）:

联发科 MTK 公布 2021 年第二季度财务报告，2021 年第二季度的营收总额为 1257 亿新台币，同比增长 85.9%，环比增长 16.3%，营收再创新高；毛利率 46.2%，同比增长 2.7 个百分点，环比增长 1.3 个百分点；净利润为 276 亿新台币，同比增长 277.4%，环比增长 7%。本季营收较前季增加的主要原因为 5G 智能手机以及各类物联网装置动能持续。本季营收较去年同期增加的主要原因为 5G 智能手机和 WiFi 6 市占率的增加以及各类消费性电子产品提升。

图 4：联发科 2021 二季度财报比较（十亿台币）

	Yearly Comparison			Sequential Comparison		
	2Q 2021	2Q 2020	YOY%	2Q 2021	1Q 2021	QOQ%
	Unit: Millions of New Taiwan dollars					
Net Sales	125,653	67,603	85.9%	125,653	108,033	16.3%
Operating costs	(67,615)	(38,197)	77.0%	(67,615)	(59,513)	13.6%
Gross profit	58,038	29,407	97.4%	58,038	48,520	19.6%
Operating expenses						
Selling expenses	(3,890)	(2,730)	42.5%	(3,890)	(3,388)	14.8%
Administrative expenses	(2,435)	(1,844)	32.0%	(2,435)	(2,508)	-2.9%
Research and development expenses	(22,879)	(17,416)	31.4%	(22,879)	(22,427)	2.0%
Total operating expenses	(29,204)	(21,991)	32.8%	(29,204)	(28,322)	3.1%
Operating income	28,834	7,416	288.8%	28,834	20,198	42.8%
Non-operating income and expenses	2,753	1,113	147.3%	2,753	8,878	-69.0%
Net income before income tax	31,587	8,529	270.4%	31,587	29,076	8.6%
Income tax expense	(4,000)	(1,219)	228.3%	(4,000)	(3,298)	21.3%
Net income	27,587	7,310	277.4%	27,587	25,777	7.0%
Net other comprehensive income	4,853	4,353	11.5%	4,853	13,541	-64.2%
Total comprehensive income	32,440	11,664	178.1%	32,440	39,318	-17.5%
Net income attributable to:						
Owners of the parent	27,511	7,204		27,511	25,572	
Non-controlling interests	76	106		76	205	
	27,587	7,310		27,587	25,777	
Basic Earnings Per Share (NTD)	17.44	4.58		17.44	16.21	

Note1: Sums may not equal totals due to rounding.

资料来源：联发科公司公告、天风证券研究所

按业务收益，手机同比增长 143%，占第二季度收入的 57%。主要受到 5G 高端产品 Dimensity1000 系列的推动，增长非常强劲。越来越多的客户持续采用公司的 5G 高端 SoCs。自 2019 年底公司首次进入 5G 高端市场以来，所占的高端市场份额一直稳步上升。计划在今年年底交付第一个 5G 旗舰 SoC 解决方案。联发科采用 ARM 最新的旗舰核心和最先进的台积电 4nm 处理技术，提供行业领先的功耗和高性能的旗舰解决方案。旗舰产品的开发已经在多个客户中取得了很好的反响，第一个客户的产品计划在 2022 年 Q1 推出。公司进入旗舰市场和对先进功能的投资将有利于未来的整个 5G 产品组合。

物联网、计算和 ASIC 部门同比增长 59%，占 22%。市场需求和产品升级持续强劲。在物联网和计算领域，WiFi 6 升级和高端设备(如更大尺寸的平板电脑、智能显示器和品牌 TWS 蓝牙耳机)带来了更好的产品组合。作为 WiFi 6 领域为数不多的领先者之一，公司预计 WiFi 6 的普及率将在未来几年加速，并将继续惠及联发科的多个应用程序。在 ASIC 方面，第二季度的收入稳步增长。一些新的开关集成电路项目将在今年下半年开始批量生产，

以促进进一步的增长。

智能家居同比增长 62%，占 14%。全球数字电视需求一直保持稳定。由于全球体育赛事的缘故，高端设备(如 4K 机型)越来越受欢迎，这推动了联发科产品组合的改善。再加上其他电视相关产品的强劲需求，预计这一部分将在今年全年保持增长。

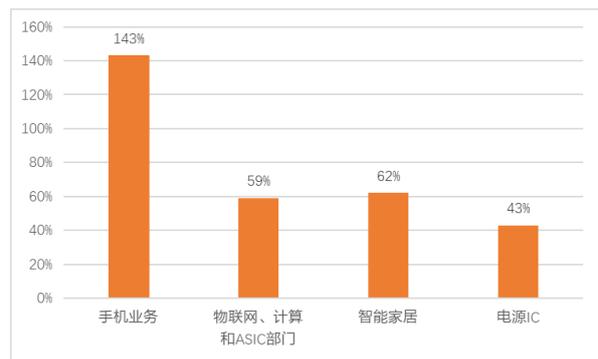
电源 IC 同比增长 43%，占 7%。整个季度需求强劲，特别是随着 5G 智能手机的发展，先进产品的技术变得越来越复杂，对高效电源管理解决方案的需求大幅增加。联发科已经建立了一个庞大的投资组合来支持多样化的应用，并继续投资于新应用的解决方案。除了计算和通信等当前主要业务的强劲增长外，工业和汽车业的贡献不断增加，预计今年工业和汽车业的贡献将占电源 IC 收入的 10% 左右。

图 5：各业务营收占比



资料来源：联发科法说会资料、天风证券研究所

图 6：各业务同比增长情况



资料来源：联发科法说会资料、天风证券研究所

展望第三季度，联发科预计收入将继续增长，季节性的供应限制不会变成对公司前景的担忧。预计第三季度的收入将在 1257-1319 亿新台币之间，预计同比增长 29%-36%。展望下半年，进一步提高年营收增长目标，从上个季度 40+% 以上提高至 45+%。年度毛利率预计在 44-46% 的目标区间上限。

2. 赛灵思 (XILINX, INC.)

FPGA 芯片全球龙头赛灵思发布 2022 年第一财季财报。公司于 2021 年 7 月 28 日宣布 2022 第一财季收入达到创纪录的 8.79 亿美元，比上一季度增长 3%。第一财季的 GAAP 净利润为 2.06 亿美元，或每股摊薄收益 0.83 美元，环比增长 11%。本季度非 GAAP 净利润为 2.36 亿美元，或每股摊薄收益 0.95 美元。得益于数据中心终端市场的强劲表现，以及工业、广播和消费终端市场创纪录的季度收入。

表 3：2022 财年第一季度财务报告摘要（单位：亿美元，每股摊薄收益除外）

	22Q1	环比	同比	21Q4	21Q1
净收入	8.79	3%	21%	8.51	7.27
毛利润	5.86	3%	19%	5.70	4.94
经营利润	2.10	5%	20%	2.00	1.76
净利润	2.06	10%	120%	1.88	0.94
每股摊薄收益	0.83	11%	118%	0.75	0.48

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所

Xilinx 总裁兼首席执行官 Victor Peng 表示：“尽管面临前所未有且充满挑战的供应受限环境，但由于对我们产品的需求依然强劲，Xilinx 又实现了创纪录的季度业绩。”此外，Xilinx 通过 Versal Edge 和 Versal HBM 系列公告扩大了 Versal 产品组合，公司继续在路线图上执行计划的同时，也在努力改善客户的供应。

赛灵思首席财务官 Brice Hill 表示：“创纪录的第一季度收入得益于数据中心终端市场的强

劲表现，以及工业、广播和消费终端市场创纪录的季度收入，这推动了 3% 的环比和 21% 的同比增长，先进产品环比增长 2%，每年增长 27%，占总收入的 72%。2022 财年第一季度公司创纪录的实现了 3.73 亿美元自由现金流，占收入的 42%。

公司的先进产品包括：Versal、UltraScale+、UltraScale 和 7 系列产品系列，以及由 Alveo、Solarflare、Network 和 System-On-Modules 组成的生产板业务。公司的核心产品包括：Virtex-6、Spartan-6、Virtex-5、CoolRunner-II、Virtex-4、Virtex-II、Spartan-3、Spartan-2、XC9500 产品、配置解决方案、软件和支持/服务。

表 4：按产品划分净收入

	22Q1 收入占比	同比	环比	21Q4 收入占比	21Q1 收入占比
先进产品	72%	27%	2%	73%	68%
核心产品	28%	8%	7%	27%	32%

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所

Brice Hill 表示，虽然由于供应链限制，库存天数接近历史低点，但一些预期的供应增加将被持续强劲的客户需求所抵消，所以，赛灵思预计库存将保持在当前水平相对稳定。第一季度东南亚新冠疫情病例激增导致向分销商的季度末出货量增加，从而导致渠道库存暂时增加。由于产品运送到最终客户，渠道库存水平在第二财季初期有所下降。

表 5：按区域划分净收入

	22Q1 收入占比	同比	环比	21Q4 收入占比	21Q1 收入占比
北美	23%	7%	-14%	27%	26%
亚太	52%	17%	11%	49%	54%
欧洲	15%	44%	0%	16%	13%
日本	10%	55%	22%	8%	7%

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所

受超大规模云客户和金融科技市场强劲需求的推动，本季度数据中心集团(DCG)收入环比增长 14%。在全球 5G 持续部署的推动下，有线和无线集团(WWG)收入同比增长 13%且环比持平。航空航天与国防、工业和测试、测量与仿真(AIT)收入环比下降 10%，创纪录的工业终端市场表现被航空航天与国防销售额下降以及 TME 小幅下降所抵消。本季度汽车、广播和消费者(ABC)收入环比增长 13%，广播和消费者终端市场季度创纪录。

表 6：按终端市场划分净收入

	22Q1 收入占比	21Q4 收入占比	21Q1 收入占比	环比	同比
航空航天与国防、工业和测试、测量和仿真	36%	41%	45%	-10%	-2%
汽车、广播和消费者	20%	18%	12%	13%	94%
有线和无线集团	30%	31%	32%	0%	13%
数据中心集团	10%	9%	12%	14%	-1%

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所

阿斯麦 (ASML Holding N.V.)

光刻机设备龙头阿斯麦 ASML 公布 2021 年第二季度财务报告，2021 年第二季度的营收额为 40 亿欧元，同比增长 20.87%，环比降低 7.88%；毛利率 50.9%，同比增加 2.7 个基点，环比降低 3 个基点；净利润 10 亿欧元，同比增加 38.22%，环比降低 22.01%。业绩提升主要受益于客户希望采用软件升级来快速提高产能。

图 7：阿斯麦 2021 二季度财报比较（百万欧元）

Quarter on Quarter

	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021
Net sales	3,326	3,958	4,254	4,364	4,020
Gross profit	1,603	1,881	2,212	2,352	2,045
Gross margin %	48.2	47.5	52.0	53.9	50.9
R&D costs	(567)	(534)	(556)	(623)	(634)
SG&A costs	(131)	(132)	(152)	(168)	(172)
Income from operations	905	1,216	1,504	1,561	1,239
Operating income as a % of net sales	27.2	30.7	35.3	35.8	30.8
Net income	751	1,062	1,351	1,331	1,038
Net income as a % of net sales	22.6	26.8	31.7	30.5	25.8
Earnings per share (basic) €	1.79	2.54	3.23	3.21	2.52
Earnings per share (diluted) €	1.79	2.53	3.23	3.20	2.52
Lithography systems sold (units) ¹	61	60	80	76	72
Net booking value ²	1,101	2,868	4,238	4,740	8,271

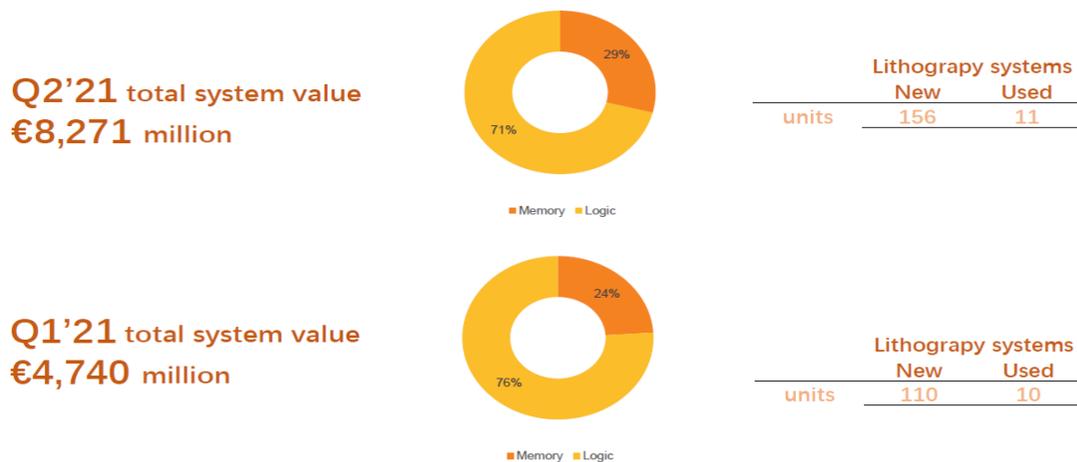
Lithography systems do not include metrology and inspection systems.

Our systems net bookings include all system sales orders for which written authorizations have been accepted (for EUV excluding the High-NA systems).

资料来源：ASML2021Q2 业绩说明会新闻稿、天风证券研究所

ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 表示：公司第二季度的营收达到 40 亿欧元，符合预期，毛利率则优于预期，达到 50.9%，主要受益于客户希望采用软件升级来快速提高产能，以及一次性的会计收入认列(one-off revenue accounting releases)。而公司第二季度的新增订单金额则达到 83 亿欧元，其中 49 亿欧元来自 EUV 系统订单，总待出货订单金额(backlog)达到 175 亿欧元。

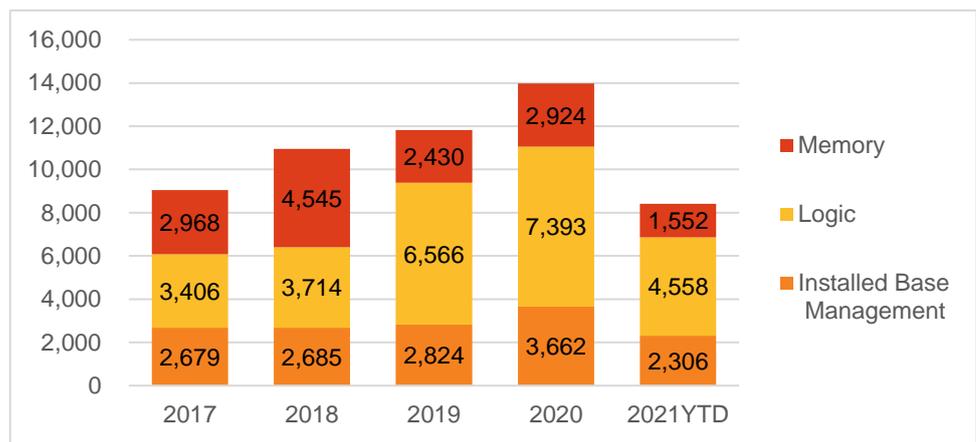
图 8：阿斯麦 2021 二季度系统总值（百万欧元、%）



资料来源：ASML2021Q2 业绩说明会新闻稿、天风证券研究所

来自于不同细分市场和对于 ASML 产品组合的需求仍然很高，主要原因是市场专注于提高产能以支持数字化基础设施的建设，这同时带动了市场对于逻辑及存储芯片的长期需求，不仅在先进制程节点方面，在成熟制程节点也是。公司正在努力将设备产量最大化，目前预计 2021 年的全年净销售额将比去年增长约 35%，预计毛利率为 51%~52%。ASML2021 年第三季度的营收预计约为 52 亿欧元~54 亿欧元，毛利率约 51%~52%，研发成本约 6.45 亿欧元，销售及管理费用约 1.8 亿欧元，预估 2021 年年化有效税率约 15%。

图 9： 2017-2021 终端使用情况（单位：百万欧元）



资料来源：ASML2021Q2 业绩说明会新闻稿、天风证券研究所

产品及业绩亮点：

- 1) EUV 业务中，第一台 TWINSCAN NXE:3600D 系统已交付给客户。与 TWINSCAN NXE:3400C 相比，该系统可提高 15% 至 20% 的生产力，并提高约 30% 的覆盖率。现在正在为内存增加 EUV 的量产，并计划在三个 DRAM 客户的未来节点上实施 EUV。
- 2) DUV 业务中，TWINSCAN NXT:2000i（一种 ArFi 浸入式系统）创下了单日在客户处曝光 6,300 多片晶圆的记录。
- 3) 第 100 次 TWINSCAN 进行了翻新，展示了公司对循环经济的承诺。今年预计将运送 20 套翻新的 PAS 系统和 6 套翻新的 TWINSCAN 系统。
- 4) 在应用程序业务中，本季度出货了第一台 YieldStar 1385。这种工具能够测量蚀刻后的器件图案，从而为客户提供扩展的良率控制能力。与 YieldStar 1375 相比，YieldStar 1385 具有更高的精度和约 50% 的生产力提升能力。

高通（Qualcomm）

高通公布 2021 年第三季度财务报告，业绩高于预期上限，非 GAAP 收入为 80 亿美元，同比增长 63%，非 GAAP 每股收益为 1.92 美元。物联网业务将是公司未来增长的机会之一，目前的增长速度也超过手机业务，是手机业务增长速度的 1.6 倍，对于推动利润率和增加运营杠杆都有作用，物联网和汽车业务，令产品组合更加优化，增加了公司的营业收入。

图 10：高通 2021 三季度财报比较（百万美元）

	Three Months Ended		Nine Months Ended	
	June 27, 2021	June 28, 2020	June 27, 2021	June 28, 2020
Revenues:				
Equipment and services	\$ 6,428	\$ 3,794	\$ 19,109	\$ 11,376
Licensing	1,632	1,099	5,121	3,809
Total revenues	8,060	4,893	24,230	15,185
Costs and expenses:				
Cost of revenues	3,404	2,080	10,325	6,489
Research and development	1,864	1,520	5,297	4,393
Selling, general and administrative	597	511	1,721	1,523
Other	—	—	—	(23)
Total costs and expenses	5,865	4,111	17,343	12,382
Operating income	2,195	782	6,887	2,803
Interest expense	(138)	(143)	(421)	(436)
Investment and other income, net	200	229	523	46
Income before income taxes	2,257	868	6,989	2,413
Income tax expense	(230)	(23)	(744)	(175)
Net income	\$ 2,027	\$ 845	\$ 6,245	\$ 2,238

资料来源：高通 21Q3 财报、天风证券研究所

QTL 收入为 15 亿美元，EBT 利润率为 71%，高于预期的中点。QCT 收入为 65 亿美元，EBT

利润率为 28%，高于预期的最高点，18 亿美元的 EBT 与去年同期相比几乎翻了三倍，收入增长了 70%，EBT 利润率增长了 12 个百分点。由于所有主要原始设备制造商在高端设备中采用 5G 产品，手机收入同比增长 57%至 39 亿美元。

图 11：高通营业收入拆分

	Three Months Ended		Nine Months Ended	
	June 27, 2021	June 28, 2020	June 27, 2021	June 28, 2020
Revenues				
QCT	\$ 6,472	\$ 3,807	\$ 19,287	\$ 11,526
QTL	1,489	1,044	4,762	3,520
QSI	11	3	30	33
Reconciling items	88	39	151	106
Total	\$ 8,060	\$ 4,893	\$ 24,230	\$ 15,185
EBT				
QCT	\$ 1,795	\$ 603	\$ 5,299	\$ 1,748
QTL	1,053	646	3,514	2,335
QSI	156	153	412	(58)
Reconciling items	(747)	(534)	(2,236)	(1,612)
Total	\$ 2,257	\$ 868	\$ 6,989	\$ 2,413

资料来源：高通 21Q3 财报、天风证券研究所

射频前端、物联网和汽车收入合计约占本季度 QCT 总收入的 40%，同比增长是手机收入快 1.6 倍。凭借广泛的产品组合和客户吸引力，RF 前端收入为 9.57 亿美元，同比增长一倍以上。射频前端收入包括功率放大器、跟踪器、天线调谐器、滤波器、分集和毫米波模块，不包括射频收发器的收入。

物联网收入同比增长 83%至 14 亿美元，比预期增加约 1 亿美元。卓越表现是由消费者边缘网络和工业平台的需求推动的。汽车收入为 2.53 亿美元，由于采用联网汽车和数字驾驶舱收入的扩大，同比增长 83%。

图 12：高通 QCT 业务拆分

	Three Months Ended			Nine Months Ended		
	June 27, 2021	June 28, 2020	Change	June 27, 2021	June 28, 2020	Change
Revenues						
Handsets (1)	\$ 3,863	\$ 2,457	\$ 1,406	\$ 12,144	\$ 7,461	\$ 4,683
RFFE (2)	957	447	510	2,921	1,509	1,412
Automotive (3)	253	138	115	705	456	249
IoT (internet of things) (4)	1,399	765	634	3,517	2,100	1,417
Total revenues	\$ 6,472	\$ 3,807	\$ 2,665	\$ 19,287	\$ 11,526	\$ 7,761
EBT (5)	\$ 1,795	\$ 603	\$ 1,192	\$ 5,299	\$ 1,748	\$ 3,551
EBT as a % of revenues	28 %	16 %	12 points	27 %	15 %	12 points

资料来源：高通 21Q3 财报、天风证券研究所

在第四财季，公司预计收入为 84 亿美元至 92 亿美元(环比 3.7%~13.5%)，非美国通用会计准则每股收益为 2.15 美元至 2.35 美元。在 QTL，公司预计收入为 14.5 亿至 16.5 亿美元，EBT 利润率为 69%至 73%。在 QCT，公司预计收入为 70 亿至 75 亿美元，EBT 利润率为 29%至 31%。QCT 的预测反映了所有收入的连续增长，包括高端设备的发布以及公司在物联网和汽车领域扩展移动技术和投资所带来的运营杠杆优势。最后，公司预计非 GAAP 合并研发和 SG&A 费用将连续增长 2%至 3%。根据第四季度指引的中间值，预计非 GAAP 每股收益为 8.24 美元，相对于 2020 财年几乎翻了一番。在 QCT 中，预计收入将同比增长 100 亿美元，营业利润率从 20 财年的 17%增长到 21 财年的 28%。随着对多元化的持续关注，预测射频前端、物联网和汽车的合并收入将从 20 财年的 60 亿美元增长到 21 财年的 100 亿美元。

超微半导体 (AMD)

IC 设计公司龙头超微半导体 AMD 公布 2021 年第二季度财务报告，收入同比增长 99%；毛利率扩大至 48%，二季度营业额为 38.5 亿美元，同比增长 99%，环比增长 12%；毛利率 48%，同比增长 4 个基点，环比增长 2 个基点；净利润 7.1 亿美元，同比增长 352%，环比增长 28%。业绩增长主要得益于计算和图形部门以及企业和嵌入式和半定制部门的收入增加。

图 13: AMD 2021 二季度财报比较 (百万美元)

	Q2 2021	Q2 2020	Y/Y	Q1 2021	Q/Q
Revenue (\$M)	\$3,850	\$1,932	Up 99%	\$3,445	Up 12%
Gross profit (\$M)	\$1,830	\$848	Up 116%	\$1,587	Up 15%
Gross margin %	48%	44%	Up 4pp	46%	Up 2pp
Operating expenses (\$M)	\$1,000	\$675	Up 48%	\$929	Up 8%
Operating income (\$M)	\$831	\$173	Up 380%	\$662	Up 26%
Operating margin %	22%	9%	Up 13pp	19%	Up 3pp
Net income (\$M)	\$710	\$157	Up 352%	\$555	Up 28%
Earnings per share	\$0.58	\$0.13	Up 346%	\$0.45	Up 29%

资料来源: AMD 公司官网、天风证券研究所

业绩增长主要得益于计算和图形部门以及企业和嵌入式和半定制部门的收入增加。毛利率的增长是由更丰富的销售组合推动的，包括高端 Ryzen™、Radeon™ 和 EPYC™ 处理器的销售。AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰博士 (Dr. Lisa Su) 表示：“我们的业务在第二季度表现异常出色，收入和营业利润率翻了一番，盈利能力同比增长了两倍多。”“由于我们所有业务的需求强劲，我们的增长速度明显快于市场。我们现在预计，在强大的执行力和客户对我们领先产品的偏好的推动下，我们 2021 年的年收入将同比增长约 60%。”

按业务分类，计算和图形部门收入为 22.5 亿美元，同比增长 65%，环比增长 7%，主要得益于锐龙台式机和笔记本处理器销售的丰富组合，客户端处理器平均销售价格 (ASP) 同比和环比增长，以及在高端图形产品销售（包括数据中心 GPU 销售）的推动下，GPU 平均售价同比和环比都有增长。企业、嵌入式和半定制部门收入为 16 亿美元，同比增长 183%，环比增长 19%。增长是由 EPYC 处理器收入和半定制产品销售增加推动的。

公司近期业务部分亮点包括：

- 1) AMD EPYC 处理器为 2021 年 6 月上市的 58 个新系统中的一半提供动力。
- 2) AMD 及其技术合作伙伴宣布了利用 AMD EPYC(霄龙)处理器的新型高性能计算系统。这些系统包括用于英国气象局的 Microsoft Azure 超级计算机、Perlmutter 超级计算机和新加坡国家超级计算中心超级计算机。
- 3) Google Cloud 和 AMD 宣布推出基于第三代 AMD EPYC 处理器的新实例 (T2D)。据谷歌云称，通过使用第三代 EPYC 处理器，与其他云实例相比，T2D 为横向扩展工作负载提供了高达 56% 的绝对性能和 40% 以上的性价比。
- 4) AMD 继续推进行业领先的封装创新，以全新 3D 小芯片技术推动高性能计算的发展。这一封装突破采用行业领先的混合键合方法，将 AMD 的创新小芯片架构与 3D 堆叠相结合。
- 5) AMD 宣布了 AMD 的优势设计框架设计结合了 AMD Radeon RX 6000M 系列移动图形

处理器，AMD 的 Radeon 软件和 AMD Ryzen 独家 AMD 智能技术和其他先进系统 5000 个系列移动处理器，提供笔记本电脑上最好的一流的游戏体验设计特点。

6) AMD 的高性能 “Zen” CPU 和 AMD RDNA™ 2 GPU 的采用扩展到新市场。

7) AMD 推出了 FidelityFX 超分辨率 (FSR)，这是一种最先进的空间放大算法功能，旨在提高帧率并提供高质量、高分辨率的游戏体验。AMD 还宣布，超过 40 家游戏开发商承诺支持 FSR，预计未来还会有更多。

三星电子 (Samsung Electronics)

三星电子公布 2021 年第二季度财务报告，营业收入为 63.67 万亿韩元，同比增长 20%，环比下降 2.6%；毛利率 41.8%，环比增长 5.3 个基点；净利润 9.63 万亿韩元，同比增长 73.2%，环比增长 34.8%。营业利润 12.6 万亿韩元，环比增加 3.2 万亿韩元，同比多增 4.4 万亿韩元。内存市场市场状况得到改善。营业利润率大幅上升至 19.7%。公司业绩变动的主要原因：1) 公司对服务器主导内存需求的积极响应和高端家用电器的稳健表现。2) 奥斯汀代工厂的运营提前恢复正常。3) 零部件供应短缺等，全球供应链的有效管理。

图 14：三星电子第二季度业绩

(Unit: KRW Trillion)	Q2 '21	% of sales	Q1 '21	% of sales	Q2 '20
Sales	63.67	100.0%	65.39	100.0%	52.97
Cost of Sales	37.07	58.2%	41.50	63.5%	31.91
Gross Profit	26.61	41.8%	23.89	36.5%	21.06
SG&A expenses	14.04	22.0%	14.51	22.2%	12.91
- R&D expenses	5.38	8.5%	5.44	8.3%	5.22
Operating Profit	12.57	19.7%	9.38	14.3%	8.15
Other non-operating income/expense	△0.14	-	△0.02	-	△0.77
Equity method gain/loss	0.19	-	0.15	-	0.09
Finance income/expense	0.26	-	0.24	-	0.31
Profit Before Income Tax	12.88	20.2%	9.75	14.9%	7.77
Income tax	3.25	-	2.61	-	2.21
Net profit	9.63	15.1%	7.14	10.9%	5.56
Profit attributable to owners of the parent	9.45	14.8%	7.09	10.8%	5.49
Basic Earnings Per Share(KRW)	1,391		1,044		808

资料来源：三星电子 2021Q2 业绩说明会资料、天风证券研究所

按业务分类，半导体部门方面，营业收入为 22.74 万亿韩元，同比增长 25%，营业利润为 6.93 万亿韩元，同比增长 28%，环比翻番，且营业利润在利润总额中的所占比例过半。疫情下非接触式生活方式走向常态，带动电脑用芯片销售增长，云计算企业对数据中心服务器的需求上升推高 D-RAM 价格，NAND 闪存价格上升，位于美国奥斯汀的系统半导体工厂复工，这些因素都为半导体部门收获佳绩发挥了作用。移动部门 (IM) 方面，营业收入为 22.67 万亿韩元，同比增长 9.3%，营业利润为 3.24 万亿韩元，同比增长 66%，环比下降 26%。新品效果不明显，加上印度和越南等地疫情扩散导致当地需求减少且生产出现差池。但公司采取改善成本结构和优化营销战略等措施，使得业绩好于去年同期。消费者家电部门 (CE) 得益于电视和高端法式多门冰箱阵容 “BESPOKE” 良好的销售业绩，实现 1.06 万亿韩元的营业利润。显示器部门实现营业利润 1.28 万亿韩元。哈曼实现营业收入为 2.42 万亿韩元，同比增长 57%，实现营业利润为 1100 亿韩元，去年同期亏损 900 亿韩元。

图 15：三星电子业务拆分

Sales

(Unit: KRW Trillion)	Q2 '21	Q1 '21	Q2 '20	QoQ	YoY
Total	63.67	65.39	52.97	3%↓	20%↑
CE	13.40	12.99	10.17	3%↑	32%↑
VD	7.17	7.22	5.31	1%↓	35%↑
IM	22.67	29.21	20.75	22%↓	9%↑
Mobile	21.43	28.20	19.80	24%↓	8%↑
DS	29.46	25.82	25.05	14%↑	18%↑
Semiconductor	22.74	19.01	18.23	20%↑	25%↑
- Memory	17.88	14.43	14.61	24%↑	22%↑
DP	6.87	6.92	6.72	1%↓	2%↑
Harman	2.42	2.37	1.54	2%↑	57%↑

Operating Profit

(Unit: KRW Trillion)	Q2 '21	Q1 '21	Q2 '20	QoQ	YoY
Total	12.57	9.38	8.15	3.18	4.42
CE	1.06	1.12	0.73	△0.05	0.33
IM	3.24	4.39	1.95	△1.16	1.29
DS	8.23	3.75	5.74	4.48	2.49
Semiconductor	6.93	3.37	5.43	3.56	1.50
DP	1.28	0.36	0.30	0.92	0.98
Harman	0.11	0.11	△0.09	△0.01	0.20

※ CE : Consumer Electronics, IM : IT & Mobile communications, DS : Device Solutions, DP : Display Panel

※ Sales and operating profit of each business stated above reflect the organizational structure as of 2021, and the sales of business units include intersegment sales.

※ Harman's sales and operating profit figures are based on Samsung Electronics' fiscal year, and acquisition related expenses are reflected.

资料来源：三星电子 2021Q2 业绩说明会资料、天风证券研究所

公司预测，合作公司拟在第三季度推出中央处理器和智能手机，这将推高 D-RAM 等存储芯片的需求，因此半导体部门第三季的营业利润有望达到顶点。

高景气度下，持续看好国产设备材料，同时看好晶圆代工板块估值修复的机遇。从 PB 估值来看，中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。中芯国际（A 股及港股）和华虹半导体自今年二季度以来显著跑输芯片 ETF。截至 2021/7/30，中芯国际港股 PB 仅 1.80，是全球 PB 最低的晶圆代工资产，华虹半导体为 3.22xPB，也处于较低水位，中芯国际 A 股 5.07xPB。

基本面持续强化，涨价+UTR 提升+产品结构优化，一季度制造板块毛利率环比提升，二季度有望持续提升。中芯国际二季度营收超 13 亿美元再创新高，毛利率提升为 30.1%，三季度销售收入预期环比成长 2%到 4%，毛利率预期在 32%到 34%之间。华虹半导体 8 月 12 日发布业绩。

大陆晶圆代工供需缺口大，中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来 5 年有望持续扩产。战略性看多本土晶圆代工资产，看好估值修复行情。

5. 周观点

看好市场上修全年预期。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，全年利润预期有望好于前期预测，景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。站在二季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期，进而带来相关股票的机会。

半导体制造：大陆晶圆代工供需缺口大，战略性看多本土晶圆代工资产，看好估值修复行情。短期来看，本轮半导体缺货涨价主要由代工产能短缺引起，代工企业有望借此机会优化产品结构，ASP 和毛利率均有望提高；长期来看，国产替代给本土晶圆代工板块带来的成长性，应优先于产业周期性考虑，中芯国际和华虹半导体作为本土晶圆代工头部公司，看好其长期发展。建议关注：**中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技/中车时代电气/华润微/士兰微**

IC 设计：一季度淡季不淡，关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。一季度淡季不淡，IC 设计板块收入同比增 70%，毛利率和净利率环比均有提高。我们看好缺货涨价在二季度的持续性。关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。建议关注：**晶晨股份/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/中颖电子/兆易创新/富瀚微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/紫光国微/斯达半导/新洁能**

半导体设备材料：成长趋势明确，受益制造产能扩张及国产替代加速。一季度 A 股半导体

设备材料板块收入增速环比提至 68%，材料板块毛利率提升，设备板块费用率下降，设备材料归母净利率均环比提高。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料成长潜力较大。建议关注：北方华创/雅克科技/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆科技

6. 风险提示

疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com